

xEV/SDV 時代で変わる実装技術

千住金属工業、「工法提案型展示」を JISSO PROTEC で展開

パワー半導体分野の実装トレンドセミナー登壇／ドキュメンタリー映像「最前線シリーズ」完結編を初公開

xEV/SDV・AI サーバ・パワー半導体の拡大を背景に、エレクトロニクスの実装を取り巻く環境が大きく変化しています。高密度化・高放熱化への対応に加え、材料価格高騰、人手不足、品質要求の高度化など、実装現場では、熱・品質・生産性・環境対応を同時に成立させることが求められています。

こうした中、はんだ材料を主軸とした接合ソリューションを展開する千住金属工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：鈴木良一）は、2026年6月10日（水）から12日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「JISSO PROTEC 2026」において、装置・材料・プロセスを組み合わせた“工法提案型展示”を展開します。

また、今回の展示では、当社初となるドキュメンタリー映像プロジェクト「最前線シリーズ」の完結編を初公開します。さらに6月12日（金）には、「パワー半導体分野における実装トレンド」をテーマとした PROTEC セミナーにも登壇します。



“装置か材料か”だけでは解決できない時代へ

実装プロセス全体を見据えた「工法提案型展示」

近年の実装現場では、熱容量の大きいデバイスの増加や高密度化に伴い、単に材料や装置を個別に選定するだけでは対応が難しいケースが増えています。

当社は今回の展示で、「モノづくりの可能性を、未来社会へ実装する。」をテーマに掲げ、材料・装置・条件を組み合わせた“工法”として実装を提案します。

ブースでは、実機・模型展示・プレゼンテーションを通じて、来場者が自社プロセスや課題に照らし合わせながら、導入時の適用イメージや検討ポイントを具体的に把握できる構成としています。

また、環境配慮型はんだ材料や低温はんだソリューション「MILATERA（ミラテラ）」をはじめ、実装に関わる分析技術も含めた SMIC グループの総合技術も紹介します。



※画像はイメージ図です。デザインは変更となる場合があります。

当社は、なぜ“実装”に向き合うのか

ドキュメンタリー映像「最前線シリーズ」完結編を初公開

会場では、当社の開発・製造・営業など、さまざまな部門の社員がどのように実装の課題と向き合っているのかを描いたドキュメンタリー映像「最前線シリーズ」第3弾、『モノづくりを実現する「実装技術」最前線』を初公開します。本シリーズは、完成品の中では見えない材料である「はんだ」を通じて、どのような人たちが、どのような思いでお客さまや社会に向き合っているのかを伝えるために企画した、当社初の映像プロジェクトです。

これまで、第1弾『自動車の安全を支える「はんだ」最前線』を2025年10月の名古屋カーエ展で、第2弾『世界をつなぐ「材料技術」最前線』を、2026年1月の東京カーエ展で、それぞれ展示会限定で公開しました。来場者からは、「材料メーカーのイメージが変わった」「技術者の考えが見える」といった声が寄せられ、ブース内でも高い注目を集めました。

完結編となる第3弾では、営業・開発・製造など異なる立場の社員が、それぞれの視点で“実装”に向き合う姿を描いています。

なお、本映像は展示会終了後、当社Webサイトでも公開予定です。



※画像は第3弾の、宮城県・栃木県・埼玉県・兵庫県で撮影された一部シーンです。

パワー半導体実装をテーマに PROTEC セミナーへ登壇

6月12日（金）には「PROTECセミナー」において、当社研究開発本部 研究員 早川めぐ美氏が登壇します。講演では、x EV/SDV や再生可能エネルギー分野で需要拡大が進むパワー半導体をテーマに、高温環境対応・大電流対応・熱マネジメントなど、次世代実装で求められる技術トレンドを解説します。

また、はんだ材料と FA 装置の双方を手掛ける立場から、接合材料だけでなく、加熱プロファイル制御や雰囲気制御など、装置側技術を含めた“実装プロセス全体の最適化”について紹介します。

さらに、材料と装置の協調設計による新たなアプローチとして、ギ酸還元雰囲気における接合技術などについても解説予定です。

■ 展示会概要

◎ 名 称：第 27 回 実装プロセステクノロジー展（JISSO PROTEC 2026）

◎ 会 期：2026 年 6 月 10 日（水）～12 日（金）10:00～17:00

◎ 会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）

◎ 展示棟：東展示棟 1 F

◎ ブース番号：1 B-49

▶ 公式サイト：<https://www.jissoprotec.jp/>

▶ 来場登録(招待券)：https://f-vr.jp/jpca/enq/mail_reg/jpca2026/event_reg_form.cgi

■ セミナー概要

パワー半導体分野における実装技術トレンド

◎ 登壇者：研究開発本部 ハンダテクニカルセンター 研究員 早川めぐ美氏

◎ 日時：2026 年 6 月 12 日（金）15:15～16:00

◎ 会場：PROTEC セミナー会場

定員は 120 名、ご参加される方は当日セミナー会場までお越しください。先着順にて受付となります。

▶ 詳細情報：https://jpca2026.tems-system.com/eguide/jp/sem/protect/seminar_details/WSalbSt-vIY#A29157315

会期中は、展示内容・実装技術トレンド・映像制作背景に関する取材対応も予定しています。

■ 会社概要

会社名：千住金属工業株式会社

本社所在地：〒120-8555 東京都足立区千住橋戸町 23

代表取締役社長：鈴木 良一

設立：1938 年 4 月 15 日

資本金：4 億 3000 万円

Web サイト：<https://www.senju.com>

本件に関するお問い合わせ先
千住金属工業株式会社 広報宣伝部
E-mail：web@senju.com